

|                  |  |             |  |
|------------------|--|-------------|--|
| PCB 板编号          | ECUC-XP-000003                                   | 投板数量 (块)    |  |
| 《硬件设计记录表》文件编号    |  | N/A         |  |
| 设计人员             | 秦力平  | 是否通过审核      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 投板目的             |  |             |  |
| 投板日期             |  | 计划交货日期      |  |
| 工艺要求             |  |             |  |
| 是否需要符合 RoHS 标准   |  | Yes         |  |
| PCB 板层数          |  | 6 层         |  |
| PCB 板厚度          |  | 1.6mm       |  |
| PCB 板材料          |  | FR-4        |  |
| 表面铜厚度            |  | 1 0z (35um) |  |
| 电镀孔表面铜厚度         |  | ≥20um       |  |
| 零件孔及焊盘表面处理       |  | 无铅喷锡        |  |
| 阻焊油颜色            |  | 绿色          |  |
| 阻焊油厚度            |  | 17.5um      |  |
| 丝印颜色             |  | 白色          |  |
| 层间对准度 (多层板)      |  |             |  |
| 线径公差             |  |             |  |
| 线间距公差            |  |             |  |
| 孔径公差             |  |             |  |
| 外形尺寸公差           |  |             |  |
| PCB 板平整度 & 最大变形量 |  | ≤0.75%      |  |
| 阻抗控制             |  | 否           |  |
| 开短路测试            |  | 是           |  |
| 绝缘测试             |  | 是           |  |
| 特殊要求             | 过孔盖油或开窗按照 Gerber 文件来制作。<br>板框按照 Keepout Layer 来做 |             |  |
| 实际交货日期           |  | 接收人         |  |
| 审核               | 杨兴华  | 批准          | 12/24/21   |
| 备注               |  |             |  |

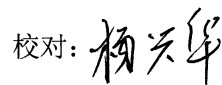
## MDD-01C SMT 作业工艺要求

1. 贴片元器件不可以有元件偏移，元件损伤，元件不贴板，元件贴反，元件飘浮，少锡，假焊，连锡。
2. 贴片过回流焊时要求温度范围不超过元器件标示的温度范围。
3. 注意接插件，电容位置不要装反，121PIN 接插件安装时要与板子齐平。插件电容要插到底不可以有空隙即歪斜。插件元器件过波峰焊时不可以有元器件烫坏。
4. 元件及部件整齐，要求 PCB 板表面干净整洁。
5. 在加工过程中要求对电子元器件的各个工位，穿静电衣，佩戴静电手环等
6. SMT 成品暂放要求，板与板之间有可靠保护或间隙，保证运输过程不会损伤元器件。
7. 贴片电感底部点胶处理，防止过回流焊是掉件。
8. 贴片时严格进行炉前炉后 AOI 检查。

批准:



校对:



编写:

